半導体製造装置事業の特徴

近年、AIを活用したデータ社会への移行が加速し、半導体は社会を支える基盤として不可欠な存在となっており、半導体市場は2030年頃には1兆米ドル程度の規模に成長すると予測されています。デジタル技術の活用が幅広い分野に拡大する中で、半導体の技術革新がさらに進み、それを支える半導体製造装置の重要性も一層高まっています。

このような状況において、半導体製造装置メーカーが継続的に事業を展開するためには、エレクトロニクスやメカニクス、プロセス、ソフトウエアなどさまざまな領域の専門性を生かし、世界最高水準の性能を備えた装置を開発することが極めて重要です。そのためには、お客さまとの確固たる信頼関係のもと早期にニーズを把握し、中長期的な視点での研究開発に取り組むとともに、最先端技術の創出に向けてアカデミアやコンソーシアムとの共創を進め、グローバルに研究開発を展開していく必要があります。これらの活動を継続的かつ確実に実行するためには、優秀な人材の確保と育成、設備投資の拡充、そして強固な経営・財務基盤の構築が不可欠です。

また半導体製造装置の安定稼動や生産性向上を支える付加価値の高い技術サービスの提供が求められています。環境負荷を低減しながら高生産性を実現するために、AIの活用をはじめとしたデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進も積極的におこなわれています。

これらに加えて、半導体産業のサステナブルな発展に向け、部品・材料の供給、装置の組み立てや調整、通関・物流などのサプライチェーン全体の連携強化も欠かすことはできません。

今後半導体製造装置メーカーには、高性能・低消費電力の半導体開発へ貢献することや、高生産性と環境負荷の低減を両立する製造技術を提供することが、さらに求められていくと考えられます。

半導体の技術革新が製造装置市場の成長を牽引

半導体製造装置メーカーに求められる要件

- エレクトロニクスやメカニクス、プロセス、ソフトウエアなどさまざまな領域の専門性
- 技術革新を実現する最高の性能を備えた装置の開発
- お客さまとの確固たる信頼関係
- 優秀な人材の確保と育成
- 中長期視点での研究開発と、それを支える強固な経営・財務基盤
- 付加価値の高い技術サービスの提供
- サステナブルなサプライチェーンの構築
- 環境負荷低減への対応

マテリアリティ

当社はビジョンの実現による基本理念の実践を通じ、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指す上で、優先して取り組むべき重要事項をマテリアリティとして位置づけ、毎年見直しをおこなっています。またマテリアリティを軸とした事業活動によるバリューチェーンの展開を通じて、新たな価値の継続的な創出に努めています。

優先して取り組むべき重要事項（マテリアリティ）

ビジョンの実現による基本理念の実践

中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上

マテリアリティの特定プロセス

環境分析・課題の抽出

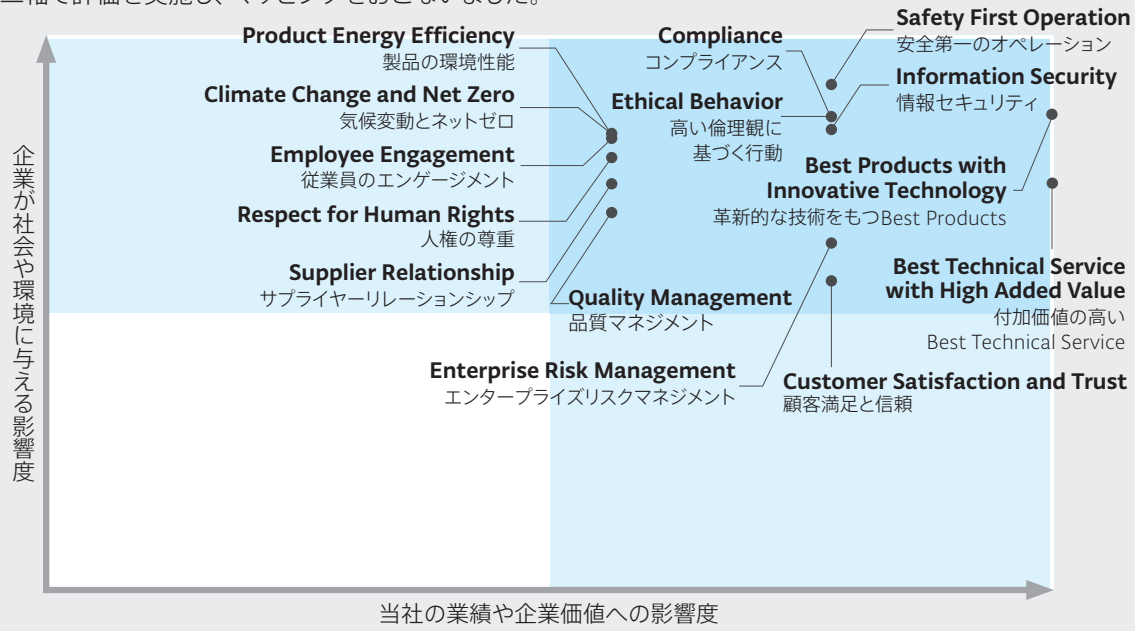
社会における課題やSDGsの取り組み状況、事業を取り巻く環境、ステークホルダーとのエンゲージメント※1結果、また当社の事業活動における重要リスク※2などを分析し、マテリアリティ候補となる課題を抽出しました。

社会における課題
- 気候変動、人権問題、貧困、教育の格差、国家間紛争や地政学上の対立、移民と難民問題、サプライチェーンマネジメント、技術と倫理、サイバーセキュリティ、物価高騰など

事業を取り巻く環境
- AIの発展を中心とするデータ社会への急速な移行に伴う半導体および半導体製造装置市場のさらなる拡大、地球環境保全への対応、人権尊重の取り組み、コーポレートガバナンスのさらなる強化など

優先順位づけ・マッピング

抽出した課題について、優先順位づけをし、ステークホルダーへの影響や関心を踏まえた「企業が社会や環境に与える影響度」と、継続的な企業価値の向上を見据えた「当社の業績や企業価値への影響度」との二軸で評価を実施し、マッピングをおこないました。



マテリアリティの特定

CEOが参加するコーポレートオフィサーズ・ミーティングにおける討議と決議、取締役会での報告と承認を経て、重要事項と評価した課題をマテリアリティとして特定しました。
加えて、継続的な企業価値の向上に関する重要指標※3や主要な16のリスク項目との関係性、取り組むSDGsについて確認をおこないました。
また、バリューチェーンとマテリアリティの関連性を整理しました。

マテリアリティの特定にあたり、そのプロセスの検討については第三者である専門家の助言を受けています。

※1 ステークホルダーエンゲージメント P. 23　※2 リスクマネジメント P. 71-72　※3 継続的な企業価値の向上に関する重要指標 P. 19-20

マテリアリティ

特定したマテリアリティ

マテリアリティ	当社におけるインパクト	社会におけるインパクト	取り組むSDGs
Climate Change and Net Zero 気候変動とネットゼロ	ネットゼロの達成に向けた事業活動や製品・サービスにおける環境負荷の低減	気候変動リスクの低減による新たな機会の創出	7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに 13 気候変動に具体的な対策を
Product Energy Efficiency 製品の環境性能	製品の環境性能強化およびプロセス性能との両立	環境に配慮した製品の提供による地球環境の保全	12 つくる責任 つかう責任 13 気候変動に具体的な対策を
Best Products with Innovative Technology 革新的な技術をもつ Best Products	革新的な技術をもつ付加価値の高い製品の創出による優位性の確立	半導体の進化によるイノベーションの促進と社会の発展	9 産業と技術革新の基盤をつくろう 13 気候変動に具体的な対策を
Best Technical Service with High Added Value 付加価値の高い Best Technical Service	お客さまの課題を解決する高度なフィールドソリューションの提供による事業機会の拡大	半導体デバイスの歩留まりや生産性の向上と装置稼動率の最大化	9 産業と技術革新の基盤をつくろう 12 つくる責任 つかう責任
Customer Satisfaction and Trust 顧客満足と信頼	唯一無二の戦略的パートナーとして顧客満足を追求し絶対的な信頼関係を構築	付加価値の提供による新たなイノベーションの創出と産業のさらなる活性化	8 働きがいも経済成長も 17 パートナーシップで目標を達成しよう
Supplier Relationship サプライヤーリレーションシップ	開発や改善、品質向上などの活動を協業により推進	サプライチェーン全体における健全性の維持や競争力の強化	9 産業と技術革新の基盤をつくろう 17 パートナーシップで目標を達成しよう
Respect for Human Rights 人権の尊重	事業活動における人権リスクの低減と個人の尊厳の尊重	差別や不平等、労働や安全などの社会課題の解決	10 人や国の不平等をなくそう 16 平和と公正をすべての人に

マテリアリティ	当社におけるインパクト	社会におけるインパクト	取り組むSDGs
Employee Engagement 従業員のエンゲージメント	個人が能力を最大限に発揮しいきいきと活動できる職場環境の構築	ステークホルダーとの信頼関係の構築による経済成長の促進	8 働きがいも経済成長も
Safety First Operation 安全第一のオペレーション	安全を最優先とすることで持続的なオペレーションを実現	社会基盤としての安全の構築	12 つくる責任 つかう責任
Quality Management 品質マネジメント	品質優先のオペレーションによる経営効率の追求	品質向上による生産性や競争力の強化	12 つくる責任 つかう責任
Compliance コンプライアンス	企業の信頼性と持続的な成長の基盤として法令や規制および業界行動規範などの遵守	社会的責任の実践による社会の健全性向上	16 平和と公正をすべての人に
Ethical Behavior 高い倫理観に基づく行動	社会的責任を自覚し従業員が誇りと幸せを感じることができる企業を目指す	公正で秩序のある社会の形成	16 平和と公正をすべての人に
Information Security 情報セキュリティ	サイバー攻撃や情報漏洩などへの迅速な対応によりデータの活用と情報セキュリティの両立を実現	利便性を損なうことなく情報の安全性を確保	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
Enterprise Risk Management エンタープライズリスクマネジメント	事業上のリスクやその影響について適切に対応することで持続的な成長を図る	リスクの排除や低減による経済や社会の継続的な発展	8 働きがいも経済成長も 9 産業と技術革新の基盤をつくろう

成長の原動力と強み

当社は、創業時より大切にしているステークホルダーとの信用・信頼を礎に独自のビジネスモデルを展開するとともに、「業界のリーディングカンパニーとして育んだ豊かな技術力」や、「確かな技術サービスに基づくお客さまからの絶対的な信頼」、また「環境変化に柔軟かつ迅速に対応できる社員とそのチャレンジ精神」を成長の原動力として培ってきました。これらの原動力により創出される強みを当社の事業活動における優位性として最大限に生かすことでさらなる成長を図っています。

成長の原動力

原動力 1

業界のリーディングカンパニーとして育んだ豊かな技術力

積極的な研究開発投資により自社開発およびお客さまとの共同開発、また世界屈指のコンソーシアムとの協業を推進することで革新的かつ多様な技術を創出

原動力 2

確かな技術サービスに基づくお客さまからの絶対的な信頼

高品質かつ高効率なサービスの提供により顧客満足の向上に努め、お客さまにとって唯一無二の戦略的パートナーとなる

原動力 3

環境変化に柔軟かつ迅速に対応できる社員とそのチャレンジ精神

「企業の成長は人。社員は価値創出の源泉」という考えのもと、社員のやる気を重視した経営を推進し夢と活力のある会社を実現

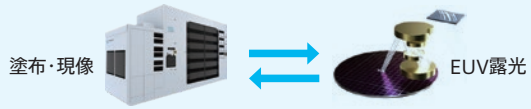
強み

4つのキープロセスに先端装置をもつ

半導体の微細加工に必要な成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄という4つのキープロセスの先端装置を提供するメーカー

100%

半導体の進化に必要なEUV※1露光用の塗布現像装置のシェア※2が100%



※1 EUV: Extreme Ultraviolet。半導体業界では特定の波長13.5nmを使用した露光技術の総称
※2 当社推定

No.1/No.2

当社の製品群は各セグメントで強いポジションにあり、いずれも市場シェア※3 1位もしくは2位を獲得

※3 当社推定
※4 各セグメントにおける当社の製品群: 拡散炉は熱処理成膜、バッチ成膜はALD (Atomic Layer Deposition) とCVD (Chemical Vapor Deposition)、メタル成膜は枚葉成膜、洗浄は枚葉洗浄とバッチ洗浄をそれぞれ含む

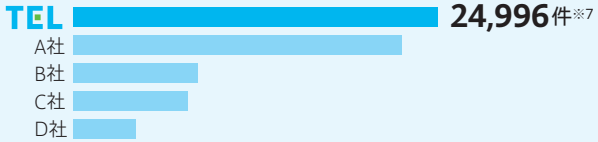
No.1

お客さまとの絶対的な信頼関係のもと、業界最大※5の出荷実績を生かして展開する技術サービスとマーケティング

※5 当社推定
※6 2025年3月末時点

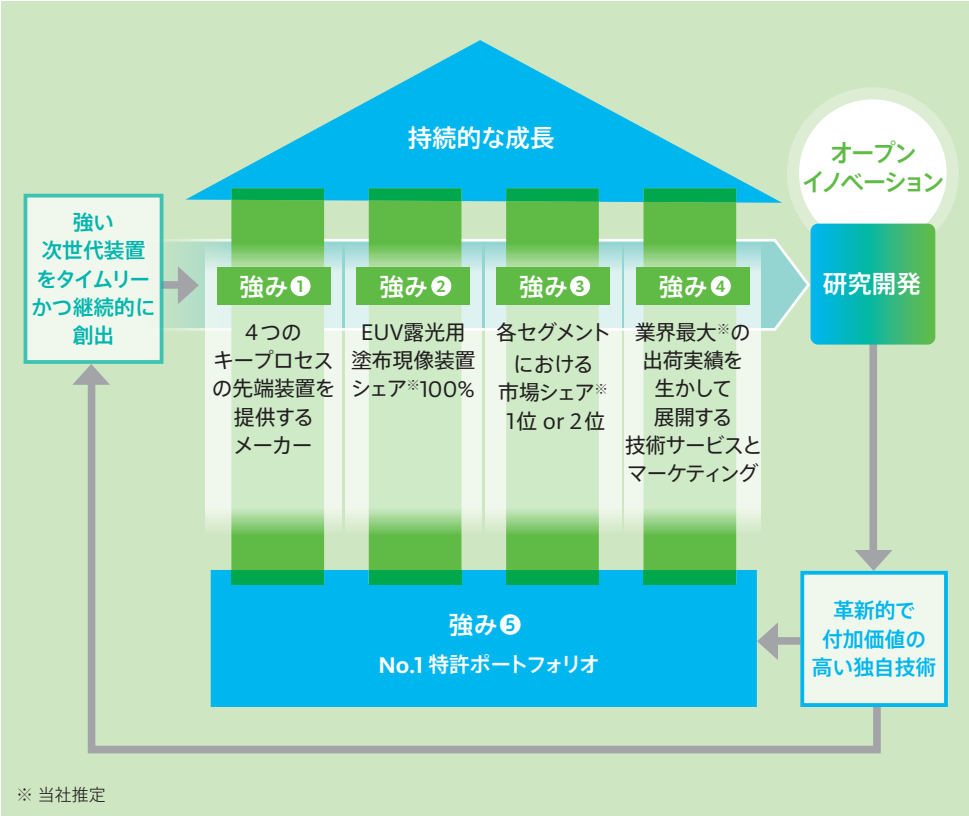
No.1

特許保有件数が半導体製造装置業界においてグローバルNo. 1



※7 2025年3月末時点。LexisNexis® PatentSight+データに基づき作成

知財・無形資産



知財・無形資産の位置づけと取り組み

技術革新が成長を牽引する半導体業界において、当社が持続的な成長を実現するためには研究開発力の強化が不可欠です。当社は4つの強み (図①～④) を生かして研究開発を進めており、これらの強みが卓越した製品競争力の源泉となっています。さらに、国内外のお客さま、コンソーシアムやアカデミアとの積極的な協業 (オープンイノベーション) を推進し、多様な知見や技術を当社の研究開発に取り込むことで、革新的で付加価値の高い独自技術を生み出しています。これにより、当社の生命線である次世代装置のタイムリーかつ継続的な創出と、5つ目の強みである特許ポートフォリオ (図⑤) の戦略的構築を可能としています。

当社では2024年に日本で1,331件、海外で296件の発明が創出され、グローバル特許出願率は6年連続で約75%を維持しています。許可率※1は、日本で77%、米国で86%に達しており、2025年3月末時点の特許保有件数は24,996件と、半導体製造装置業界でNo. 1を維持しています。当社の特許ポートフォリオは、他社への影響力や技術的価値の上昇度においても高く評価されており、2024年に引き続き「Clarivate Top 100 グローバル・イノベーター 2025」および「LexisNexis Innovation Momentum 2025: The Global Top 100」に選出されています。こうした競争力のある特許ポートフォリオは、製品の差別化やお客さまとの絶対的な信頼関係の構築にもつながります。また、当社の4つの強みを支えることで、中長期的な企業価値向上の基盤として重要な役割を果たしており、当社の持続的な成長を後押ししています。

Top 100 Global Innovator 2025
Clarivate

さらに、特許ポートフォリオの優位性を支えている発明者の知的財産創出活動を促進するため、独自の表彰制度※2を設けています。初めて特許出願に至った発明者から、特に優れた模範となる発明者まで、さまざまなステージに合わせて表彰をおこなうことで、積極的な知的財産創出活動や発明精神の継承を推進し、製品競争力の継続的な向上を図っています。

※1 2024年算出値
※2 当社ウェブサイト「発明者表彰制度」www.tel.co.jp/rd/intellectualproperty/index.html

知的財産ガバナンス体制

当社は、国内外の主要開発拠点に配置された知的財産部門と本社の知的財産部が連携し、研究開発部門や事業部門とも密接に協働することで、技術革新と市場ニーズを的確に捉えた知的財産ポートフォリオの強化を進めています。また、取締役会やコーポレートオフィサーズ・ミーティングにおいて、知的財産活動や知的財産リスクに関する報告を定期的に実施し、経営層との連携を通じた知的財産ガバナンス体制の一層の強化に努めています。

中期経営計画

当社は「最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します」という基本理念のもと、技術革新のスピードが著しいエレクトロニクス産業において半導体製造装置のリーディングカンパニーとしてビジネスを展開しています。2023年3月期にはさらなる成長を目指して「半導体の技術革新に貢献する夢と活力のある会社」という新たなビジョンを掲げるとともに、中期経営計画を発表し、その達成に向けたさまざまな取り組みを推進しています。

財務目標

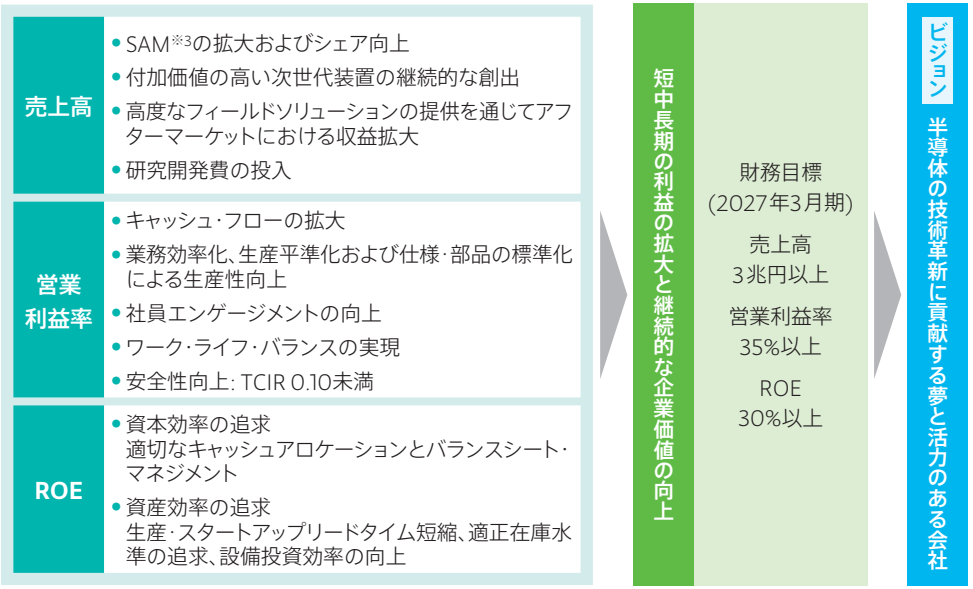
中期経営計画においては、ワールドクラスの営業利益率とROE (自己資本利益率) のさらなる向上に向けて、2027年3月期までに売上高3兆円以上、営業利益率35%以上、ROE 30%以上を目指す財務目標を設定しています。半導体の重要性が一段と高まり、半導体製造装置市場が今後も大きく成長し続けることが予想される中、当社はバリューチェーン全体におけるさまざまな取り組みを進めるとともに、Best Products、Best Technical Serviceを常に追求し、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指していきます。

	2025年3月期実績	財務目標 (達成時期: 2027年3月期)
売上高	2兆4,315億円	3兆円以上
営業利益率	28.7%	35%以上
ROE	30.3%	30%以上

主な取り組み※1

- 当社が得意とする分野や蓄積された技術、経営ノウハウが生きる分野でビジネスを展開
- 将来、お客さまが必要とする高付加価値のnext-generation productsをいち早く市場に投入するとともに、最高水準の技術サービスを提供
- 積極的な研究開発投資を実施
- 当社がこれまで出荷した約96,000台※2の装置をもとにパーツ販売やアップグレード改造、稼動率向上に取り組み、お客さまが生産するデバイスの歩留まり向上などの課題解決に努めるとともに、これらの高度なフィールドソリューションの提供を通じてアフターマーケットにおける収益拡大を図る。また今後、累積100,000台以上となっていく出荷済装置のサポートに備え、遠隔保守サービスおよび装置の稼動データやAIを活用した予知保全など、高効率かつ高付加価値サービスの構築にも注力
- 環境にフォーカスしたイニシアティブ「E-COMPASS」を展開し、サプライチェーン全体で半導体の技術革新と環境負荷低減の実現を目指した活動を実施。2041年3月期までに温室効果ガス排出を実質ゼロにするネットゼロ目標を設定し、当社グループ内のみならず、お客さまやパートナー企業さまと連携しながら環境負荷低減を推進

※1 これらの取り組みに加え、さらなる高い利益の創出と企業価値の向上を目指し、2025年3月期からの5年間の成長投資、人材投資を計画。研究開発投資: 1.5兆円以上、設備投資: 7,000億円以上、人材採用: グローバルで累計10,000名の採用
※2 2025年3月末時点



※3 SAM: Served Available Market

中期経営計画 | 財務責任者メッセージ

当社はビジョンの実現と財務目標の達成に向けて、以下の戦略や政策を実践するとともに、資本市場との対話を通じて企業価値・株主価値の向上に寄与してまいります。

川本 弘
常務執行役員
ファイナンス本部
ディビジョンオフィサー

1 成長戦略

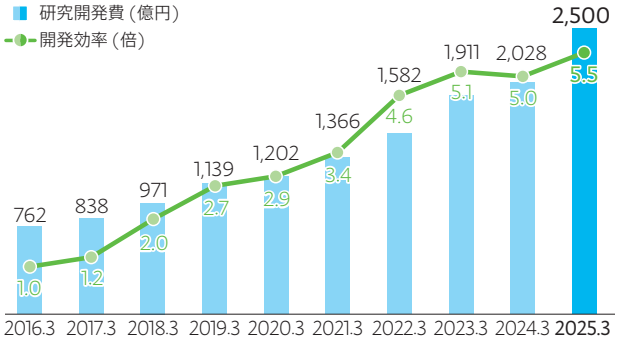
- 売上高3兆円以上、営業利益率35%以上、ROE30%以上を2027年3月期までに達成する中期財務目標を設定
- 資産効率をさらに高め、キャッシュ･フローの拡大に努めることで、ROE向上など高い資本効率を追求
- 創出したキャッシュを社会の持続的な発展を支える半導体の技術革新を生み出すための成長投資、人材投資に活用

2025年3月期は、過去最高の2兆4,315億円の売上高、6,973億円の営業利益を達成し、ROEも目標とする30%以上となりました。さらなる成長に向け、以下の取り組みを2025年3月期からの5カ年計画として、進めております。

- 1.5兆円以上となる積極的な研究開発投資
- 研究開発および生産能力の拡大、生産性向上に向けた7,000億円以上の設備投資
- グローバルで累計10,000名の人材採用

同時に、将来に向けた成長投資の実行においては、効率をさらに高めていくことが重要であると認識しています。当社はお客さまや社外との多様な連携により、技術動向と顧客ニーズを的確に把握することに努め、これを研究開発活動に反映しております。またデジタル技術を活用した業務改善活動についても、取り組みを強化しています。右図は当社の開発効率の推移を示しており、競合他社を上回る水準を維持しています。今後も効率を意識しながら、付加価値の高い「ナンバーワン」、「オンリーワン」製品の創出と業務効率の向上を目指してまいります。

研究開発費と開発効率※の推移



※ 直近5カ年の営業利益の合計額を6～10期前の研究開発費の合計で割って集計

2 財務戦略

- 事業拡大を見据えた運転資金の確保による経営の安定化
- 強固な財務体質の維持
- 適切なキャッシュアロケーション、バランスシート・マネジメントの追求

当社はこれまで半導体製造装置業界におけるリーディングカンパニーとして大きな成長を遂げてきました。引き続き次の成長投資に向けてキャッシュを有効活用し、高い成長ポテンシャルをもつ分野でさらなる事業の拡大を追求することで、中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。そして中期財務目標の具現化に向けて、適切な財務戦略を実行してまいります。

2025年3月期については、開発費控除前の営業キャッシュ･フローとして8,321億円を創出し、そのおよそ半分を成長投資に、半分を株主さまへの還元として分配しました。今後も獲得したキャッシュをバランス良くアロケーションし、持続的な企業成長と株主価値の向上を両立してまいります。

3 資本政策

- 自社の企業価値の的確な把握と株価や時価総額の評価
- 資本コストや資本収益性を意識した最適な資本構成の実現
- キャッシュ・フロー拡大に基づく継続的かつ積極的な株主還元の実行

4 株主還元策

- 株主さまへの配当については業績連動型を基本とし、親会社株主に帰属する当期純利益に対する連結配当性向50%を目処とする※
- 自己株式の取得については現状のキャッシュポジションや中長期的な成長投資資金、株価水準、総還元額の状況などに鑑み、機動的に実施

※ ただし1株当たりの年間配当金は50円を下回らないこととし、2期連続で当期純利益を生まなかった場合は、配当金の見直しを検討

2025年3月期の株主さまへの総還元額（配当および自己株式取得額）は過去最高の4,227億円となりました。総還元比率は78%となり、高水準の還元をおこないました。

中期財務目標を達成し、高水準の配当と機動的な自己株式の取得による株主還元を通して株主価値を引き続き高めてまいります。

中期経営計画

前工程事業本部

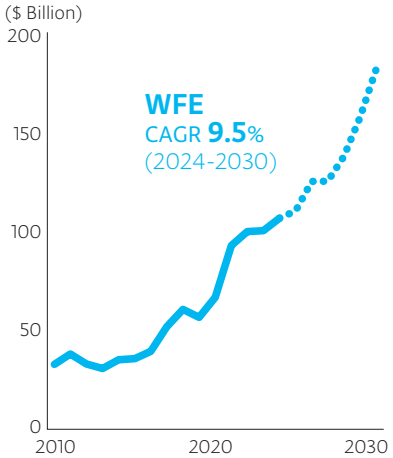
石田 博之
コーポレートオフィサー　常務執行役員
前工程事業本部担当 兼 ディビジョンオフィサー

半導体市場は2030年頃に1兆米ドル程度の規模になると見込まれており、その成長ドライバーはAIです。AI半導体向けには、先端デバイス、先端パッケージやテストなど、その性能を担保するための手法は多様化していますが、その中でも半導体の高性能化や微細化が引き続き重要です。当社は、半導体の高性能化や微細化を実現するカギとなる多くの前工程製造プロセスを担う主要なプレイヤーであり、そのポジションをさらに強化すべく積極的な技術開発を進めています。セグメント別に見ると、エッチングや成膜などの分野においてWFE※1の成長率を上回る伸びが期待されており、前工程事業では多くの開発POR※2を獲得しています。今後も中長期的にWFEをアウトパフォームする成長を目指すとともに、積極的な技術開発への投資を通じて、半導体市場の成長に強く貢献してまいります。

事業機会

AIの進展に伴い、成長が期待される先端ロジックとDRAMにおいてはエッチングのTAM※3の成長率が一段と高まり、成膜においても先端ロジック向けでは高い成長が見込まれます。AI向けデバイスの用途の広がりに牽引され市場が拡大する中、各デバイスのさらなる高性能化や微細化による高付加価値化が今後も継続していくことが予想されます。さまざまな技術変革点への対応は、当社にとって大きな成長機会となります。また1兆米ドル規模の市場における事業展開に向けて、人的リソース不足やネットゼロ達成などの産業構造的な課題に対応することも、成長機会の拡大につながります。

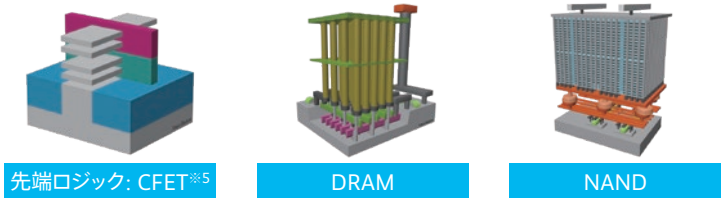
半導体製造装置市場



Source : TechInsights (April 2025)

事業戦略

先端ロジックにおいては、成膜・エッチングの精密制御、高選択比のガスケミカルエッチング、ルテニウムなどの新材料やエアギャップなどの新構造への対応をおこなうとともに、露光での性能とコストの両立に向けた、EUVの高NA化、マルチパターニングとの併用、レジストへのMOR※4採用に加え、EUV適用回数の最適化に向けた異方性エッチングの評価を進めていきます。DRAMにおいては、2次元の微細化を成立させるキャパシタ容量の確保のため、高アスペクト比エッチングと、高難度なキャパシタ成膜へのニーズに対応するとともに、新構造の4F²縦型チャネルトランジスタや、3次元構造への変化における成膜、エッチング、ガスケミカルエッチングの技術開発も強化していきます。NANDにおいては、積層数の増加を実現するため、当社の深い穴スリット向けの極低温エッチング開発を強化することに加え、次世代遷移金属材料のワードラインへの適用や、チャネルシリコンの低抵抗化に対応します。高性能化と微細化において極めて重要な役割を果たす多くの技術開発を通じて、半導体の進化に大きく貢献するとともに、新製品の提供により当社事業の参入領域を拡大し、WFEの水準を上回る成長を目指します。さらに、デジタル化と地球環境保全に向けた脱炭素化の両立を図る「デジタル×グリーン」への対応も強化していきます。



※1 WFE: Wafer Fab Equipment。半導体製造工程には、ウェーハ状態で回路形成・検査をする前工程と、そのウェーハをチップごとに切断し、組み立て・検査をする後工程がある。半導体前工程製造装置は、この前工程で使用される製造装置のこと。また半導体前工程製造装置は、ウェーハレベルパッケージング用の装置を含む
※2 POR: Process of Record
※3 TAM: Total Available Market
※4 MOR: Metal Oxide Resist
※5 CFET: Complementary Field Effect Transistor

前工程事業における当社の優位性

- 高性能化や微細化のカギとなるエッチング、成膜を強い開発体制で実現
- EUVを塗布現像装置と最適化技術で支える
- パターニングにおける4つのキープロセスの先端装置を駆使し全体最適の解を提供

中期経営計画

後工程事業本部

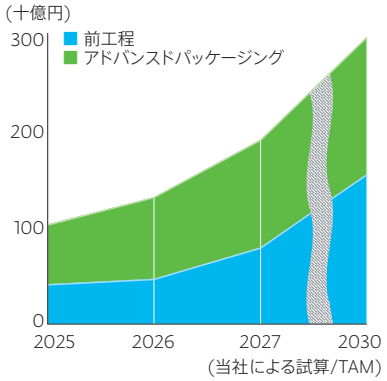
秋山 啓一
コーポレートオフィサー　常務執行役員
後工程事業本部担当 兼 ディビジョンオフィサー

これまでHPC※1やAI向けデバイスにおいてトランジスタ数の増加を牽引してきたムーアの法則に加えて、近年ではその実現に大きく寄与する、複数チップを2次元、3次元方向に実装する先端パッケージング技術が注目されております。デバイス性能の向上に向けて、半導体製造工程ではこのような半導体同士を直接ボンディングする技術の導入が加速しており、次世代デバイス製造における重要な技術転換点として、今後もさらなる技術革新が期待されています。当社の強みは、実績のある前工程技術をボンディングに必要な各種技術に活用できる点にあります。加えて、お客さまに近接した場所に当社の開発評価センターを設置することで迅速な開発・サポートを実現し、エンゲージメントの強化を一層図っていきます。引き続き、お客さまの実デバイスでの評価を加速させ、量産化に向けた取り組みを推進してまいります。

事業機会

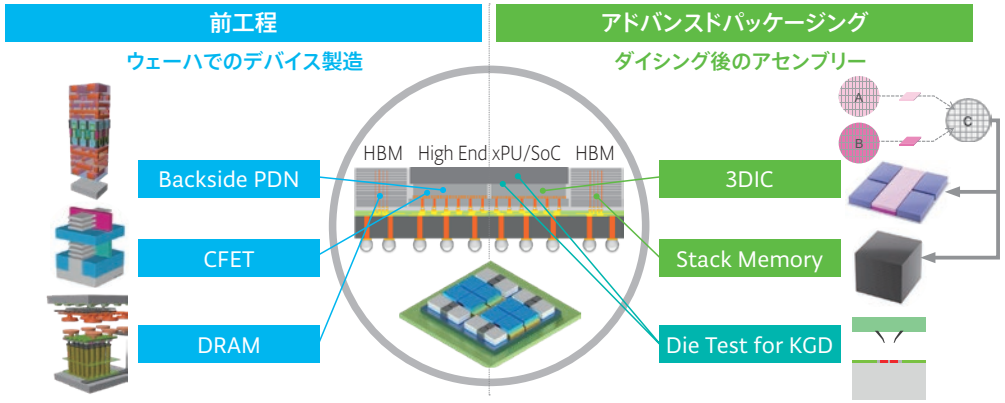
当社は、参入しているボンディング工程の製造装置市場規模が2025年から2030年までの年平均成長率(CAGR) 24%という高い成長を遂げると見込んでおり、2030年には3,000億円規模に達すると予測しています※2。前工程のすべての先端デバイスにおいてボンディング技術の採用が進むと見られており、例えばロジック半導体ではBackside PDN※3と呼ばれる裏面配線構造や次世代トランジスタ CFET、次世代DRAMにおいてはボンディング技術による開発が進んでいます。また、先端パッケージング工程の3DICやHBM※4を代表とするStack Memoryにおいてはすでに、ボンディング技術を用いた量産が進展しています。

ボンディング工程に関する製造装置市場規模



事業戦略

当社はボンディング市場でのシェアを最大化すべく、ウェーハボンディング装置「Synapse™ Si」、レーザエッジトリミング装置「Ulucus™ L」、先端レーザ剥離装置「Ulucus™ LX」に加え、複数チップを1つに実装する先端パッケージ (Die to Wafer) の製品開発も進めており、将来にわたる多くの事業機会に対して必要かつ効果的なプロセスをタイムリーに提案していきます。また先端パッケージ (Die to Wafer) で課題となる実装後の歩留まり向上には、KGD※5と呼ばれる個片化されたチップを100%良品に近付けることが重要であり、当社保有の最新ウェーハプローバ「Prexa™」による吸熱技術を用いた開発・評価にて、そのアプローチを実現していきます。ボンディング装置は、プラズマ制御や洗浄技術からなるプロセス技術と、メカニカルなアライメント技術が融合されてでき上がるプロセス装置であり、当社の前工程事業で保有している成膜、塗布・現像、エッチング、洗浄で培った先端技術やノウハウを取り入れることで、効率的な製品開発を継続していきます。



※1 HPC: High Performance Computing
※2 当社による試算
※3 Backside PDN: Backside Power Delivery Network
※4 HBM: High Bandwidth Memory
※5 KGD: Known Good Die。信頼性も含めて品質保証されている半導体チップ

後工程事業における当社の優位性

- 大きな成長が見込まれるボンディング市場に対し、革新的な製品群を幅広く投入
- 前工程事業で培った技術やノウハウを活用することで、迅速で効果的な開発が可能
- ボンディングとテスト技術を融合することによる、歩留まり向上へのアプローチ

中期経営計画

継続的な企業価値の向上に関する重要指標

中期経営計画において、財務およびサステナビリティに関する指標を「継続的な企業価値の向上に関する重要指標」として明確にし、これらの重要指標と関連する主なマテリアリティを確認しています。CEOが参加する四半期レビュー会議にて定期的に進捗状況やアクションプランの確認をおこない、各指標における責任者のもとさまざまな活動を展開しています。

当社ウェブサイト「サステナビリティ目標と実績」 www.tel.co.jp/sustainability/goals-and-results/index.html

○: 順調に進行中　△: 目標達成に向けて加速が必要

対象分野		指標	達成時期	2025年3月期実績	進捗評価	関連する主なマテリアリティ
財務		● 売上高: 3兆円以上	2027年3月期	● 2兆4,315億円	○	
		● 営業利益率: 35%以上	2027年3月期	● 28.7%	○	
		● ROE: 30%以上	2027年3月期	● 30.3%	○	
研究開発		● 5年間で1兆円以上の研究開発費の投入による付加価値の高い next-generation productsの継続的な創出	2027年3月期	● 研究開発費 2,500億円 (2023年3月期からの累積6,440億円)	○	
環境	事業所	● CO_2総排出量: 85%削減 (2019年3月期比)	2031年3月期	● 73%削減	○	
		● 再生可能エネルギー使用比率: 100%	2031年3月期	● 89%	○	
		● 各事業所におけるエネルギー使用量 (原単位): 前期比1%削減	毎期	● 11事業所中、6事業所において達成	△	
		● 各事業所における水使用量 (原単位): 各基準期水準を維持	毎期	● 13目標中、10目標において達成	○	
	物流	● モーダルシフトおよび共同配送のさらなる推進による物流全体 (自社配送分) のCO_2排出量: 30%削減	2027年3月期	● 22.4%削減	○	
		● 製品の木材梱包の使用比率を50%以下に削減 (半導体製造装置の梱包)※ ※ 2026年3月期より目標変更「製品の木材梱包の使用比率を40%以下に削減 (半導体製造装置の梱包) (2027年3月期まで)」	2025年3月期	● 通期 65.3% (第4四半期 56.3%)	○	
	製品	● ウェーハ1枚当たりのCO_2排出量: 55%削減※ (2022年3月期比) ※ お客さまの再生可能エネルギー導入による削減を含む	2031年3月期	● 21%削減	○	
社員	エンゲージメント	● エンゲージメント・サーベイのスコア: 継続的な改善 (前回比スコア上昇)、もしくは各地域における他社平均値を超えるスコアを達成	毎回	● スコア上昇: 19ポイント (グローバル全体、2016年3月期から2025年3月期) ● 各地域の状況: 7拠点中5拠点で他社平均を上回る	○	
		● 社員の定着率※　日本: 99% 海外: 業界平均以上 ※ 定年などによる退職は除く	毎期	● 日本: 99.1% ● 海外: 業界平均以上 (97.6%)	○	
	キャリア	● 一人ひとりが上長や周囲のサポートを実感し、自分の将来 (キャリアパス) をイメージしながらやりたいことにチャレンジし成長することで、会社の成長や社会のために価値創出できる環境を構築※ ※ 2026年3月期より目標追加「オンライン学習年間利用者率　グローバル 60%」	2027年3月期	● キャリアの可視化、自立的なスキル取得の仕組み (仕事図鑑、トレーニングプログラムなど) を導入 ● エンゲージメント・サーベイスコア「キャリア機会」 日本: 前回比＋3ポイント グローバル: 前回比＋1ポイント ● キャリアに関するオンライン学習利用者の増加率 (年間) グローバル: ＋24ポイント (56%)	○	

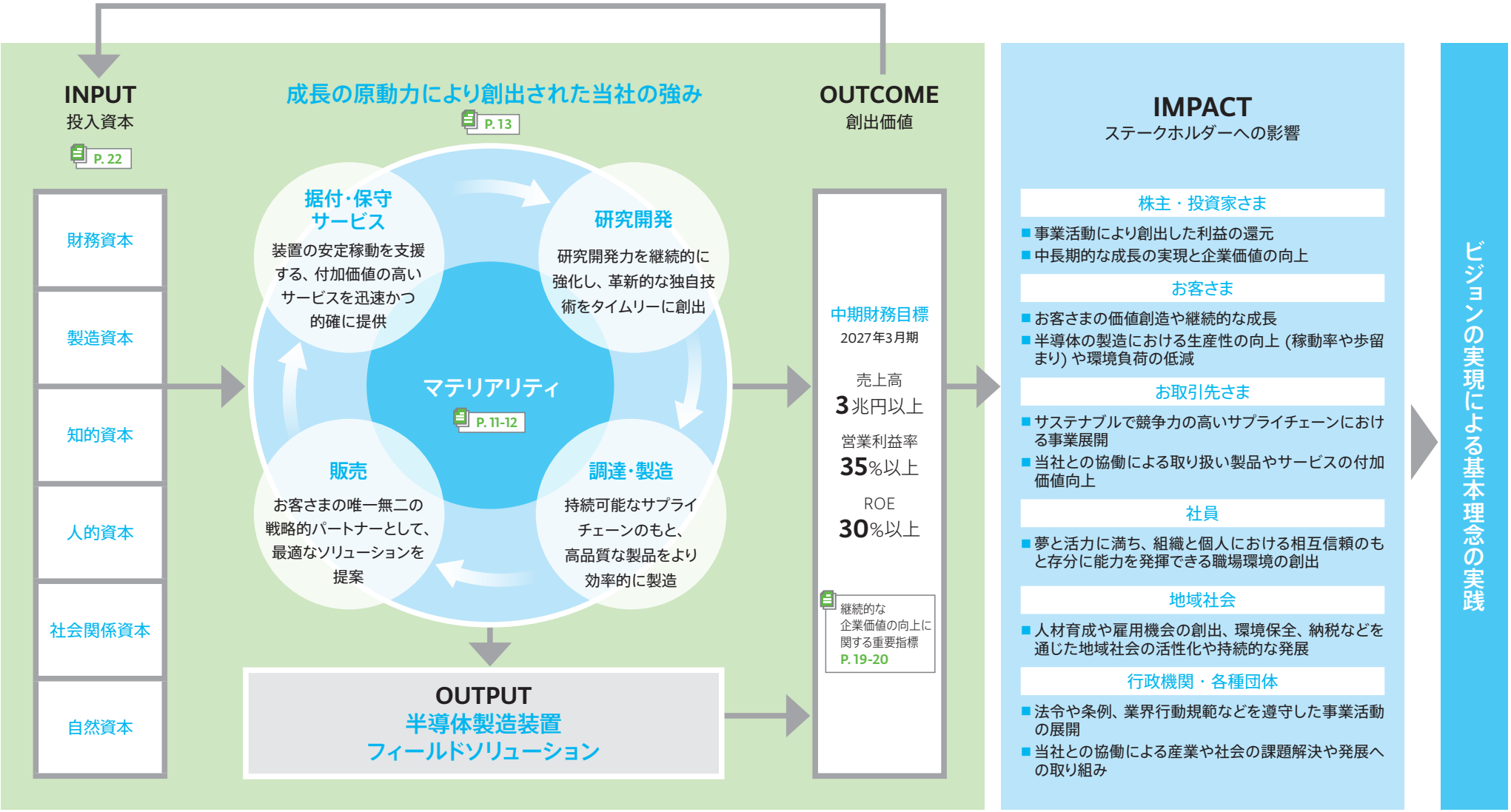
中期経営計画

○: 順調に進行中　△: 目標達成に向けて加速が必要

対象分野		指標	達成時期	2025年3月期実績	進捗評価	関連する主なマテリアリティ
社員	ワーク・ライフ・バランス	● 有給休暇取得率　日本: ①80%　②90% 海外: 前期実績と同等以上 ※ 2026年3月期より目標追加「男性育児休業取得率　日本: 85% (2030年3月期まで)」	日本: ①2027年3月期 ②2031年3月期 海外:毎期	● 日本: 78.9% ● 海外: 78.9% (前期実績69.0%)	○	
社員	DE&I	● 女性管理職比率　日本: 5% グローバル: 8%※ ※ 本目標は当社グループの米国地域には適用されません	2027年3月期	● 日本: 3.3% ● グローバル: 6.4%	△	
サプライチェーンマネジメント		● サプライチェーンサステナビリティアセスメントの実施率 資材系: 調達額の85%以上 物流系: 通関関連業者100% 人材系: 派遣会社および請負会社 (構内請負) 100% ● アセスメント結果に応じた改善活動の実施	毎期	● アセスメント実施率: 調査票の改定および実施時期の見直しにより2025年3月期は実施なし (2025年5月に実施) ● 改善活動: アセスメント結果から改善の優先度が高いお取引先さまに対し改善活動を要請、エンゲージメントの推進と進捗確認を実施	○	
サプライチェーンマネジメント		● サプライチェーンBCPアセスメントの実施率 資材系: 調達額の85%以上 ● アセスメント結果に応じた改善活動の実施	毎期	● アセスメント実施率: 資材系: 調達額の85%以上を達成 ● 改善活動: アセスメント結果から課題を把握し、是正に向けた計画を策定・実施	○	
安全		● TCIR※ 0.10未満 (業界グローバル1位) ※ TCIR: Total Case Incident Rate。労働時間20万時間当たりの人身事故発生率	2027年3月期	● TCIR 0.23	△	
コーポレートガバナンス		● 常に最適で実効性の高い取締役会と攻めの経営執行体制を構築し、取締役会の実効性評価や機関投資家などからの意見を踏まえた課題に継続的に取り組むことで、中長期的な企業価値向上と持続的成長に向けた強固なガバナンスを実現	毎期	1. 実効性の高い取締役会を目指して ● 監査役会設置会社を継続 社外取締役比率過半数 (7名中4名) を実現 指名委員会で社外取締役候補者とコンタクト継続 ● オフサイトミーティング 2回 (8月、3月) ● 取締役会で原則毎回、CEOによる業務執行に関する重要事項を説明 ● CEOミッション: 取締役会メンバーと共有 ● 代表取締役評価に関するクローズドセッション: 2回 2. 業務執行を支えるオペレーティングリズム ● コーポレートオフィサーズ・ミーティング: 21回 ● CSSミーティング: 2回 ● 四半期レビュー会議: 4回	○	
リスクマネジメント		● 強固な経営基盤を支える実効性の高いリスクマネジメント体制の構築とさらなる改善 ● 「Safety, Quality and Compliance. Our top priority. It's our pride.」の標語を掲げ、リスクマネジメントおよびコンプライアンス遵守を強化	毎期	● 当社の主要なリスクとして「ファイナンス」「M&A」「IT&オペレーション」「拠点展開」の4項目を追加し、全16項目のリスクに対してオーナーを明確化してグローバルでのリスクマネジメント体制を推進 ● 製品コンプライアンスリスク (禁止物質、輸出規制など) におけるグループ全体での対応力を強化するため、2024年12月に本社と国内製造拠点の情報交換会 (製品コンプライアンス定例会) の運用を開始	○	

価値創造モデル

当社は保有する資本を最大限に活用し (INPUT)、強みを生かしながらマテリアリティを軸とした事業活動によるバリューチェーンを展開しています。これにより創出される価値 (OUTCOME) をステークホルダーに提供します。そしてビジョンの実現による基本理念の実践を通じ、中長期的な利益の拡大と継続的な企業価値の向上を目指しています。



価値創造モデル

資本	INPUT (投入資本) 2025年3月期	OUTCOME (創出価値) 2025年3月期
財務資本	●純資産 **18,552**億円 ●自己資本比率 **70.1**% ●総資産 **26,259**億円	●売上高 **24,315**億円 ●営業利益率 **28.7**% ●当期純利益 **5,441**億円 ●ROE **30.3**% ●年間配当総額 **2,727**億円 (配当性向50.1%)
製造資本	●製造拠点 合計 **9** (国内6、海外3) ●新工場建屋や設備など製造に関する設備投資 ●部品の標準化・生産の平準化 ●製造オペレーションにおける長年培ったノウハウや実績 ●製造基幹システム	●累計出荷台数 約**96,000**台 (年間出荷台数 約4,000~6,000台) ●最先端技術を備えた高品質、高信頼性の製品 ●安全第一のオペレーション TCIR **0.23** ●生産リードタイムの短縮
知的資本	●研究開発拠点 合計 **16** (国内8、海外8) ●研究開発投資 **2,500**億円 ●複数の領域における高い専門性とそれらを統合して製品化する能力 ●半導体製造プロセスにおける幅広い知見と総合的な技術力 ●お客さまのご要望や技術動向 ●デジタル技術やナレッジマネジメントにより蓄積された装置関連データ	●革新的で付加価値の高い独自技術 ●市場シェア **1**位または**2**位の製品ラインアップ ●半導体製造における最適なソリューション ●特許保有件数 **24,996**件 ●高品質かつ高効率なサービス
人的資本	●従業員数 **19,573**名 ●エンジニア比率 **68.7**% ●さまざまな専門分野の知見を備えた人材 ●グローバルに活躍できる人材 ●TEL UNIVERSITYによる人材開発	●定着率※1 **97.6**% ●価値創出の源泉である社員の成長意欲の向上とチャレンジ精神の発揮 ●エンゲージメントの高い社員によるステークホルダーとの信頼関係の構築 ●女性管理職比率※2 **6.4**% ※1 離職率のデータを用いて算出 ※2 高度専門職と定年後再雇用者を含む
社会関係資本	●長年の実績に基づくお客さまとの信頼関係 ●お取引先さまとの強固なパートナーシップ ●地域社会における事業活動の基盤 ●業界団体における同業他社との連携	●顧客満足度調査「大変満足」・「満足」回答割合※3 **100**% ●事業活動を展開する地域における雇用機会の創出と国・地方自治体への納税 ●TEL FOR GOOD※4プログラム数 **287**件 ※3 ご回答いただいたすべてのお客さまのスコア平均値を設問ごとに算出 ※4 当社の社会貢献活動を表すブランドネーム
自然資本	●エネルギー使用量 **537,978**MWh ●水使用量 **1,587**千m^3	●自社のCO_2排出量 **73**%削減 (2019年3月期比、再生可能エネルギー導入などによるCO_2排出量127千t 削減) ●製品使用時のCO_2排出量 (ウェーハ1枚当たり) **21**%削減 (2022年3月期比) ●廃棄物リサイクル率 **99.2**%

ステークホルダーエンゲージメント

当社では、ステークホルダーとの対話の機会を積極的に設け相互コミュニケーションを図ることにより、ステークホルダーからの要請や期待を的確に把握し事業活動を展開しています。社会における役割と責任を確実に果たしていくことで、当社を取り巻くすべてのステークホルダーとの確固たる信頼関係の構築に努めています。

ステークホルダー	ステークホルダーとの関係性	ステークホルダーへの提供価値	主なエンゲージメント機会
株主・投資家さま	●株主・投資家さまは、当社に資本を提供するとともに、建設的な対話や株主総会での議決権の行使を通して、株主･投資家さま視点でのご意見やご要望、当社への期待を明示 ●当社は、経営ビジョンや成長シナリオを共有するとともに、株主・投資家さまからいただいたご意見やご要望を経営に生かし、企業価値の向上を図る	●事業活動により創出した利益の還元 ●中長期的な成長の実現による企業価値の向上	●決算説明会/中期経営計画説明会/IR Day ●IRカンファレンス/IRロードショー※/個別IR取材 ●株主総会 ●国内外の主要な半導体やテクノロジー関連の展示会で併催される投資家向けイベント（CEO登壇） ※ IRロードショー：株主・投資家さまを直接訪問するIR活動
お客さま	●お客さまは、当社が提供する半導体製造装置を購入するとともに、それら装置のメンテナンスなどに必要なサービスを利用 ●当社は、製品やサービスおよびソリューションの提供のみならず、お客さまと複数世代にわたる技術ロードマップを共創し、共同で技術開発を実施	●革新的な技術をもつBest Products ●付加価値の高いBest Technical Service ●安全と品質を重視し、環境に配慮した製品やサービス ●多様なアプリケーションに対応するソリューション	●技術交流会 ●共同開発 ●顧客満足度調査
お取引先さま	●お取引先さまは、当社の事業運営において必要な資材や人材、また通関やロジスティクスなどの役務を提供 ●当社は、お取引先さまが提供する資材や役務などを購入するとともに、それらの開発や改善および品質向上に協働して取り組む。また労働、環境、安全衛生、倫理などに配慮したサステナブルなサプライチェーンを構築	●当社との協働による製品やサービスのさらなる付加価値の向上および社会課題への取り組みの推進 ●半導体製造装置市場における事業機会 ●サプライチェーン全体における健全性の維持や競争力の強化	●生産動向説明会 ●TELパートナーズデイ/TEL E-COMPASS Day ●サステナビリティアセスメント ●STQA※監査 ※ STQA: Supplier Total Quality Assessment
社員	●社員は、個々の能力を生かし、また教育機会の活用などにより成長を図ることで、企業価値の向上に寄与 ●当社では、社員のやる気を重視した経営のもと、エンゲージメントの向上を推進	●夢と活力に満ち、組織と個人における相互信頼のもと多様性を尊重し存分に能力を発揮できる職場環境 ●キャリア形成やスキルアップの機会 ●公正な人事評価と成果に見合った報酬	●社員集会 ●グローバル・エンゲージメント・サーベイ ●研修やワークショップ
地域社会	●地域社会は、地場産業の発展や人材の育成などを図り、地域社会としての価値向上に努める ●当社は、事業を展開する地域において雇用機会の創出や環境保全の取り組み、納税などにより、地域社会の発展に貢献	●人材育成と雇用機会 ●地域における環境保全の推進 ●納税による財務的な貢献	●TEL FOR GOOD (社会貢献活動) ●事業所見学会 ●環境報告会
行政機関・各種団体	●行政機関・各種団体は、法令や条例、業界行動規範などの遵守を企業に求めるとともに、企業と連携し産業全体および国や地域レベルでの発展を目指す ●当社は、事業を展開する国や地域において、法令や条例、業界行動規範などを遵守した事業活動をおこなうとともに、社会の要請を的確に捉え、課題解決や発展に貢献	●産業や社会の課題解決や発展に貢献するソリューション ●法令や条例、業界行動規範などを遵守した事業活動	●政府・行政機関との連携 ●国際的なイニシアティブやNGOなどとの協働 ●業界団体における活動